日月光半導體2022年獎學金申請辦法

**第一條、目的：**

為培育半導體產業專才，日月光（以下稱「本公司」）成立「菁英培育獎學金」，嘉惠優秀學子、促進學業進步，特訂定本辦法。

**第二條、獎學金申請對象：**

1. 學歷: 具日間部 碩士在學學歷，不限學校地區
2. 科系：電子、電機、機械、物理、化學、材料等理工科系
3. 戶籍：不限戶籍地區
4. 其他條件: 開放申請獎學金學生，可合併申請研替

**第三條、獎學金金額：**

1. 早鳥加碼: 獎學金方案開放申請之日起一個月內完成報名，嗣後經甲方審核錄取，完成合約簽署，次月發放100,000元。
2. 每月發放: 每名學生每月補助10,000元，共計21個月。(補助未滿21個月於報到次月補足21萬元。)

**第四條、獎學金申請方式及程序：**

1. 申請時間： 碩一至2022/5/31止；碩二至2022/3/31止
2. 申請方式：學生應於公告截止日前完成線上報名，取得早鳥加碼資格，並檢附第九條申請文件， (以線上報名時間為憑)。

線上報名： <https://www.surveycake.com/s/xaz1z>

E-mail：[Annie\_Chen@aseglobal.com](mailto:Annie_Chen@aseglobal.com)

TEL：07-3617131分機83049

1. 審查：由本公司進行初步資格審查，審查通過將另行通知面試日期。
2. 經公告錄取之學生（以下稱「獎助生」），需完成履約協定之簽約手續，否則視同放棄。

**第五條、獎學金權利及義務說明**

1. 本獎學金每月由本公司以金融機構轉存方式直接發與獎助生。
2. 獎助生應於畢業或退伍後三十日內郵寄履歷通知予下述單位，將其畢業或退伍一事告知本公司，以利本公司安排其聘用事宜。並於約定報到日至日月光高雄廠履約任職兩年。
3. 如乙方畢業後即至甲方服研發替代役，服役期間計入前項之履約期間。

E-mail：[Annie\_Chen@aseglobal.com](mailto:Annie_Chen@aseglobal.com)

招募任用部 陳小姐 (獎學金作業)

TEL： 07-3617131分機83049

1. 奬助生任職待遇由本公司員工聘用敘薪規定辦理並承諾以不低於同等學歷初任待遇任用。若無法履行義務者，須退回全部所領獎學金。
2. 本公司得依公司整體發展方向、業務需求、人力缺口狀況、奬助生專長並參酌獎助生意願分配其工作崗位分發，獎助生同意接受分發結果。
3. 本獎學金每月發放時，獎助生仍須為原校理工科系在校生(每學期須檢附在校證明)，若不符合前述條件即失去資格，須退回全部所領獎學金。
4. 畢業後履約期間於公司內考績若為D或屬IR連續兩次人員者或違反公司管理規範屬重大情節者，將依履約比例退回補助獎學金。

**第六條、獎助權利解除條件**

乙方發生以下事由之一時，甲方得提前終止或解除本合約，乙方應返還於本合約終止或解除前已受領之全部獎學金予甲方：

1. 有轉學、休學、退學或約定修業期限屆滿仍無法畢業之情形。但如乙方經甲方同意其休學，且休學期間不逾一年者，則不在此限。前述休學以一次為限。
2. 於在學期間或兵役期間，非經甲方同意，至其他任何企業任職（不論全職或兼職），或於其他公司或機構服研發替代役。
3. 洩漏其所接觸或知悉之甲方及（或）甲方關係企業之機密資訊。
4. 修習表現不佳，在學期間必修科目有一科（含）以上不及格者。
5. 於在學期間違反校規、無正當理由不參與正常教學活動，或行為有妨礙甲方聲譽或校譽之虞，經輔導後仍未改善者。
6. 於在學期間或服役期間有違反法令、行為有悖於善良風俗者。

**第七條、違約罰則**

1. 獎助生畢業或退伍且經本公司聘用後，未依約定至本公司報到或未履行服務承諾者，獎助生應返還其所領取之獎助金額。
2. 獎助生畢業後雖於本公司任職服務但履行服務承諾年限未達二年，獎助生應依照已履行服務年限比例，比例返還培訓補助。

**第八條、申請文件**

1. 日月光菁英培育獎學金申請表
2. 個人履歷自傳
3. 學生證及身份證正反面影本各乙份
4. 檢附大學/碩士歷年成績單

**日月光菁英培育獎學金申請表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **學　　校** |  | **科　　系** |  |
| **姓　　名** |  | **學　　號** |  |
| **聯絡手機** |  | **家裡電話** |  |
| **E-MAIL** |  | | |
| **住　　址** |  | | |
| **繳驗證件** | **□個人履歷自傳 □大學/碩士歷年成績單 □身份證影本(審核戶籍使用)**  **□學生證影本 □申請研替 □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **預計研究計畫題目/方向：** | | | |

**【個人資料蒐集、處理及利用告知事項】**

**為保護台端權益，請詳閱以下告知事項，台端於下表提供個人資料並簽名即表示已理解 並同意以下規定：**

本公司基於招募聘用、人事管理、行政作業及相關營運需要之目的（下合稱「特定目的」）有必要於所在地以紙本、電子文件、電磁紀錄或其他合於當時科學技術之適當方式，在符合個人資料保護相關法令之範圍內，蒐集、於國內與國際間處理與利用台端於上表及未來所提供之個人資料（下稱「個人資料」），並得於特定目的消失後保存至少15年。台端個人資料利用對象包括本公司及本公司國內外關係企業（下稱「本公司關係企業」）、本公司及本公司關係企業之職工福利委員會、財團法人日月之光慈善事業基金會、財團法人日月光文教基金會、以上公司、關係企業及組織之職員、代理人、專業顧問、及其所委託之第三人以及依法令得提供其台端個人資料之人。台端得依個人資料保護法第三條行使之相關權利包括(1)查詢或請求閱覽(2)請求製給複製本(3)請求補充或更正(4)請求停止蒐集、處理或利用(5)請求刪除。台端若需行使上述權利，請洽本公司人力資源處。台端若拒絕提供相關個人資料或未確實完整填寫，本公司可能無法進行相關審核及處理作業而影響台端之應徵或申請機會。

收件日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 學生簽章\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_